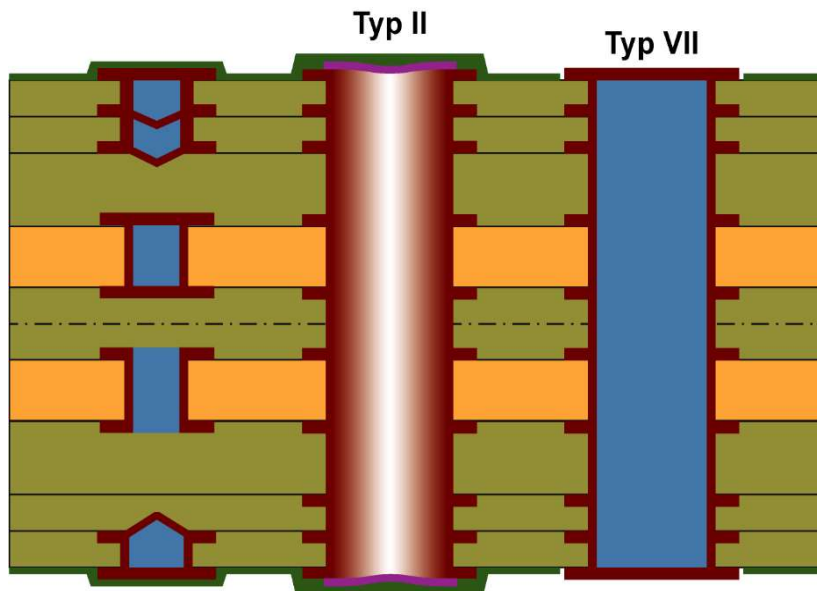


Zaplňování otvorů

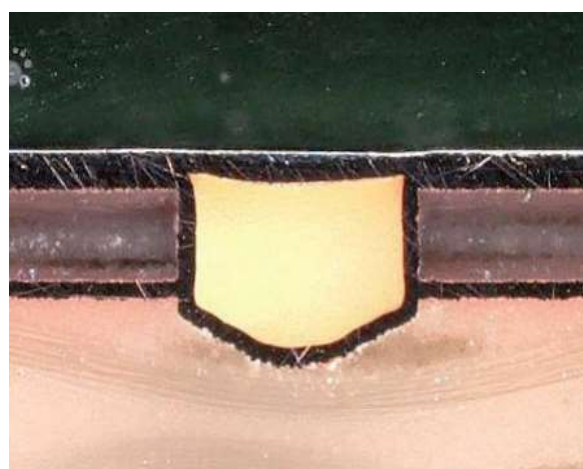
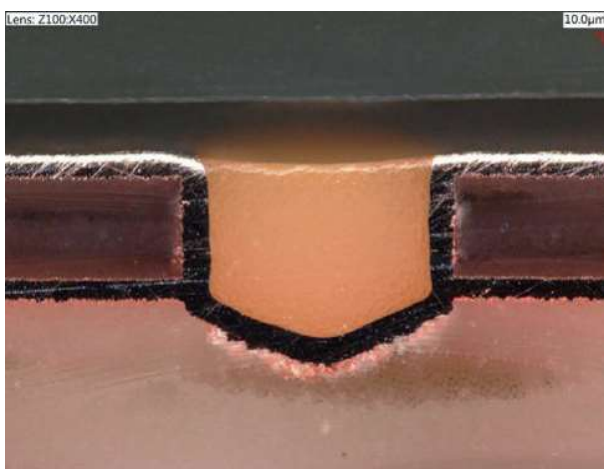
Zaplňování nevodivou pastou

Pro plnění otvorů využíváme technologii od firmy I.T.C. , která díky dvěma hlavám dokáže zaplnit i slepé otvory. Desky zaplňujeme dle IPC 4761 typem VII. Otvory jsou přeplátované mědí a finální povrchovou úpravou. Technologie tedy umožňuje via-in-pad.



Legenda: laminát nevodivá pasta nepájivá maska Cu nakovení suchý rezist

Pokud není uvedeno jinak, zaplňují se vždy všechny prokovy (VIA) do průměru vrtáku 0,45mm. Je ideální specifikovat průměr otvoru, které zákazník požaduje zaplnit, případně uvést maximální průměr zaplněných otvorů. Pokud požadujete zaplnit pouze vybrané otvory (oblast), je nutné tyto specifikovat v samostatné vrstvě, případně příloženým výkresem.



Zaplňování suchým rezistem

Vnitřek otvoru není vyplněn nevodivou pastou, ale je pouze oboustraně zakryt suchým rezistem a následně překryt nepájivou maskou. Průměr vrtaného otvoru max. 0,35 mm.



Informace o pastě – specifikace

otvor po nakovení	min. 0,1 mm
otvor po nakovení	max. 2,0 mm
aspect ratio pro prokovené otvory	max. 40:1
aspect ratio pro slepé vrtání	max. 1:15
dle specifikace IPC-4761 jsme schopni zajistit typ zaplnění	VII
tloušťka DPS	0,4–3,2 mm

Zaplňovaný otvor musí být 5 mm od hrany desky.

Více o TAYIO pastě: <https://www.gatema.cz/file-link/plnici-pasta-tds-thp-100dx1.pdf>

aspectratio plugging from 1:1 to 1:40

